公司代码:688689 公司简称:银河微电

常州银河世纪微电子股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

详情敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为12,840万股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利4,494.00万元(含税),占2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的31.90%。2021年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,独立董事及监事会均发表明确同意意见,尚需提交股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	银河微电	688689	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李福承	邱欣莹
办公地址	常州市新北区长江北路19号	常州市新北区长江北路19号
电话	0519-68859335	0519-68859335
电子信箱	gmesec@gmesemi.cn	gmesec@gmesemi.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业,致力于成为半导体分立器件细分领域的专业供应商及电子器件封测行业的优质制造商。公司以客户应用需求为导向,以封装测试专业技术为基础,积极拓展二极管芯片制造技术,初步具备IDM模式下的一体化经营能力,可以为客户提供适用性强、可靠性高的系列产品及技术解决方案,满足客户一站式采购的需求。

2.主要产品或服务情况

公司主营各类小信号器件(小信号二极管、小信号三极管、小信号MOSFET)、功率器件(功率二极管、功率三极管、功率MOSFET、桥式整流器),同时还生产车用LED灯珠、光电耦合器等光电器件和少量三端稳压电路、线性恒流IC等其他电子器件。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域,并可以为客户进行封测定制加工。

(二) 主要经营模式

公司坚持以客户需求为导向,依托技术研发和品质管控能力,积极实施包括多门类系列化器件设计、部分晶种芯片制造、多工艺平台封测生产以及销售服务的一体化整合(IDM),采用规模生产与柔性定制相结合的生产组织方式,以自主品牌产品直销为主满足客户的需求,从而实现盈利。

1.采购模式

公司采用“集中管理、分散采购”的模式,将供应链管理的规范性和适应产销需求的采购快捷灵活性有效地结合起来,并通过计划订单拉动和安全库存管控相结合的方式,达到兼顾快速交付订单和有效管控存货风险的要求。

2.生产模式

公司采用“以销定产,柔性组织”的生产模式。公司依据专业工艺构建产品事业部组织生产,以实现产能的规模效应和专业化管理。同时,公司以市场为导向,努力构造并不断优化适应客户需求的多品种、多批次、定制化、快捷交付的柔性化生产组织模式。

3.营销模式

公司依托自主品牌和长期积累的客户资源,采用“直销为主、一站式配套”的营销模式。公司建有较强的营销团队和集客户要求识别、产品设计、应用服务、失效分析等为一体的技术服务团队,依托丰富的产品种类和专业化的技术支持,为客户提供一站式采购服务。

4.研发模式

公司采用“自主研发、持续改善”的研发模式,并在产学研合作方面展开探索和尝试。公司技术研发中心统一组织管理新产品研发以及技术储备研发活动,涵盖需求识别、产品设计、新材料导入、芯片制造和封测、模拟试验和验证、应用服务等各个技术环节,构建相互支撑、持续改善的系统性创新体系。

公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化,未来还将继续保持。公司将以技术创新为基础,积极整合各类资源,充分满足下游产业和客户对产品的需求,促进公司业务的持续健康发展。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售,属于新一代信息技术领域的半导体行业。半导体行业位于电子行业的中游,是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。半导体产品按结构和功能可进一步细分为分立器件和集成电路,分立器件与集成电路共同构成半导体产业两大分支。近年来,分立器件占全球半导体市场规模的比例基本稳定维持在18%-20%之间。

与海外半导体产业进入成熟阶段不同,我国半导体处在奋起追赶的发展黄金窗口期,产业发展任重道远。近年来,我国分立器件企业紧跟国际先进技术发展,通过持续的技术创新不断推动产品升级,在技术研发和先进装备方面进行了大量的投资,并积极向中高端市场渗透,与国际厂商展开竞争,已经在消费电子等细分应用领域取得了一定的竞争优势。

(2)行业的基本特点

半导体行业需要持续的高投入,具有资金密集、技术密集的特点,导致明显的头部集中格局。以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业占据了全球半导体分立器件的主要市场份额,2018年度前十大分立器件公司均为国外企业,前十大半导体分立器件企业市场占有率合计达到63.50%,市场集中度较高。

半导体行业是研发最密集的行业,国际领先企业掌握着中高端芯片制造技术和先进的封装技术,其研发投入强度高于国内企业,全球排名前三的半导体分立器件企业英飞凌、安森美及意法半导体在2019年度的研发费用分别占到营业收入的11.77%、11.61%及15.72%,高于国内同行业可比公司,在全球竞争中保持优势地位。

半导体行业下游需求领域广泛,景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。我国已经成为全球制造业第一大国和全球最大电子产品消费市场,根据WSTS的数据显示,2019年度我国半导体市场销售额占到全球的35%,而且仍在不断上升。根据中国半导体行业协会的数据显示,2013年-2019年我国半导体分立器件产业销售收入由1,536亿元增长至2,772亿元,年复合增长率为10.34%,保持较高的增长速度。

半导体分立器件技术研发的重点是提高效率、增加性能和减少体积,不断发展新的器件理论和结构,促进各种新型分立器件的发明和应用。未来技术发展将会呈现以下几个特点:

①新型功率半导体分立器件将不断出现,替代原有市场应用的同时,还将开拓出新的应用领域。如美国Gree公司研发出用于移动WiMAX用途的新的高功率GaN RF功率晶体管,在40v、3.3GHz下峰值脉冲输出功率达到创记录的400W。

②新材料、新技术不断得到发展和应用。为了使现有功率半导体分立器件能适应市场需求的快速变化,需要启用新技术,不断改进材料性能或研发新的应用材料,继续优化完善结构设计、制造工艺和封装技术等,提高器件的性能,如第三代半导体材料SiC、GaN等的应用。

③体积小型化、组装模块化、功能系统化趋势明显。电子信息产品的小型化、甚至微型化,必然要求其各部分零部件尽可能小型化、微型化、多功能。为适应整机装备效率和提高整机性能的可靠性、稳定性的需求,半导体分立器件将会趋向模块化、集成化。

(3)行业的主要技术门槛

半导体分立器件的研发及生产过程涉及半导体物理、微电子、材料学、机械工程、电子信息等众多学科,需要综合掌握和应用器件设计、芯片制造、封装测试、应用试验等专业技术,属于技术密集型行业。随着下游应用场景不断更新和拓展,电子产品的升级频率更加快速,对半导体分立器件产品的性能参数、可靠性、稳定性等都有持续提升的要求,下游应用对供应商快速满足其新需求的配套设计能力和技术服务支持能力的需求也越来越高。因此,本行业对新进入者具有较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从全球市场来看,半导体分立器件市场集中度较高,且由于国外企业的技术领先优势,几乎垄断了汽车电子、工业控制、医疗设备等利润率较高的应用领域。因此,总体而言,国内半导体分立器件企业与国际领先企业在规模及技术上都存在一定差距。

我国半导体分立器件市场呈现金字塔格局,第一梯队为国际大型半导体分立器件公司,凭借先进技术占据优势地位;第二梯队为国内少数具备IDM经营能力的领先企业,通过长期技术积累形成了一定的自主创新能力,在部分优势领域逐步实现进口替代;第三梯队是从事特定环节生产制造的企业,如某种芯片设计制造、或几种规格封装测试。

公司通过长期的行业深耕,在多门类系列化器件设计、部分晶种芯片制造、多工艺封装测试等环节均掌握了一系列核心技术,具备较强的根据客户需求进行产品定制,并以多工艺制造平台制造生产来满足客户需求的能力,在国内属于具备一定技术优势的半导体分立器件厂商。

小信号器件是公司的核心优势产品,布局较早,具备先发优势,在国内市场的占有率超过5%。是该领域的知名自主品牌。公司在功率器件领域具有一定的市场影响力,属于国内半导体分立器件行业中规模较大的领先企业。

客户认证是半导体分立器件行业的核心门槛之一,公司在计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域得到了诸多知名龙头客户的长期认可,并随着公司技术水平的不断提升,产品逐步进入工业控制、安防设备、汽车电子、医疗器械等应用领域,具备较强的客户认证优势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处细分行业为半导体分立器件行业,硅材料平台目前仍然是主流的半导体分立器件工艺平台,并将在未来相当一段时间内占据主要市场,但新的半导体材料,如SiC、GaN工艺平台正在逐步走向成熟。半导体分立器件的封测沿着尺寸更小、功率密度更高的方向发展,芯片逐步向高性能、高可靠性方向发展。

在封测方面,目前业内从第一代产品到第五代产品均在量产过程中,即使是第一代产品,如能跟上需求端的变化,仍具有顽强的生命力,如TO-247封装属于第一代产品,但新的TO-247在原来有3个引脚的基础上增加一个引脚,使其可以采用Kelvin连接的信号源端子进行栅极驱动,降低封装内电源线电感的影响,从而进一步提高MOSFET芯片的高速开关性能。其在超结MOSFET产品上获得了广泛应用。由于各代封装固有的特性优势,预计在众多领域的需求还会持续共存。第三、四代产品不断有新的封装出现,在多颗产品集成、功率增强等方面持续前进。目前在公司自主生产的产品中,封装形式主要集中在前三代,第四代封装已经实现量产,第五代封装尚处于试样阶段,还未形成收入。

在芯片方面,公司从功率二极管芯片的工艺和结构两个方面着手,积极推进技术研发活动,以满足持续提升产品性能和可靠性的需求。对二极管芯片钝化结构和工艺的提升,进一步改善反向特性和温度特性。在MOSFET芯片制程中,进一步发展SGT、Trench、深沟槽、多层外延、复合结构等技术,优化电荷平衡、优化栅极结构,进一步提升导通电阻、栅极电荷、低静态与动态损耗等性能。

半导体分立器件产业链主要包含器件及芯片设计、芯片制造、封装测试三大工艺环节,根据所涉及经营环节的不同,经营模式分为纵向一体化(IDM)以及垂直分工两种。由于分立器件在投资规模方面采用IDM模式具备经济效益上的可行性,同时分立器件的产品设计和生产工艺都会对产品性能产生较大的影响,对器件设计与制造工艺的整合能力要求较高,因此业内领先企业一般都沿着逐步完善IDM环节的模式发展。公司以封装测试专业技术为基础,逐步拓展部分功率二极管芯片的设计和制造能力,已经初步具备了IDM模式下的一体化经营能力。

近年来,分立器件产品的国产化趋势日益明显,半导体的进口替代被提升到国家战略层面。一方面国内厂商具备一定的效率和成本优势,并随着近年来国内半导体产业的发展,领先企业的产品结构不断升级,已经逐步具备了参与到中、高端市场竞争的能力。另一方面,为保证供应链的稳定性,之前主要依赖进口分立器件的诸多国内知名客户也纷纷转向寻找国内供应商。全球数字化转型,云服务、服务器、笔记本电脑、游戏和健康医疗的需求不断上升,5G、物联网、汽车、人工智能和机器学习等技术的快速发展,也一起推动了市场对半导体产品的需求。因此,借助于国家产业基金、金融和税收政策的支持,国内领先企业将成为进口替代和参与国际市场竞争的主力军,面向新兴电子产品的分立器件产品和工业级、车规级产品是重要发展方向。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,390,429,749.32	809,105,481.52	71.85	699,439,280.72
归属于上市公司股东的净资产	1,074,550,646.22	576,207,758.29	86.49	505,956,237.66
营业收入	832,354,020.45	610,235,005.07	36.40	527,893,779.40
归属于上市公司股东的净利润	140,871,314.60	69,538,921.58	102.58	52,724,499.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,346,071.87	57,125,303.17	126.43	49,611,410.82
经营活动产生的现金流量净额	112,890,594.29	74,297,702.95	51.94	106,376,790.55
加权平均净资产收益率(%)	14.32	12.85	增加1.47个百分点	11.02
基本每股收益(元/股)	1.12	0.72	56.56	0.56
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.72	56.56	0.56
研发投入占营业收入的比例(%)	5.71	5.79	减少0.08个百分点	6.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	172,120,876.56	232,383,341.40	211,920,194.26	215,929,608.23
归属于上市公司股东的净利润	17,622,038.00	40,224,043.97	47,447,284.74	35,577,947.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,917,423.27	38,503,787.32	44,524,156.06	29,400,705.22
经营活动产生的现金流量净额	15,904,060.11	29,273,833.82	26,550,611.38	41,162,088.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因财务人员失误,导致2021年前三季度合并现金流量表“投资支付的现金”多计188,902.37元,“支付的各项税费”少计188,902.37元。年度报告中分季度的经营活动产生的现金流量净额已更新。

为给投资者提供更完整、更充分的现金流量信息,公司从2021年开始,对理财产品的现金流入及流出按总额法在现金流量表相关项目中列示及将购买、赎回理财产品产生的现金流入和现金流出改按总额法统计列示。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于定期报告的更正公告》(公告编号:2022-017)。

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							8,540
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
						股份状态 数量	
常州银河星源投资有限公司	0	40,747,740	31.74	40,747,740	40,747,740	无 0	境内非国有法人
恒星国际有限公司	0	34,473,000	26.85	34,473,000	34,473,000	无 0	境外法人
常州银江投资管理中心(有限合伙)	0	8,182,260	6.37	8,182,260	8,182,260	无 0	其他
常州银冠投资管理中心(有限合伙)	0	5,508,000	4.29	5,508,000	5,508,000	无 0	其他
常州清源知本创业投资合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	3.50	4,500,000	4,500,000	无 0	其他
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)	0	2,889,000	2.25	2,889,000	2,889,000	无 0	其他
中信建投投资有限公司	1,196,800	1,196,800	0.93	1,196,800	1,605,000	无 0	境内非国有法人
UBS AG	1,076,796	1,076,796	0.84	0	0	无 0	未知
法国兴业银行	378,165	378,165	0.29	0	0	无 0	未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	313,951	313,951	0.24	0	0	无 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末,银河星源持有公司31.74%的股权,为公司的控股股东;杨森茂先生通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接控制公司39.25%的股权,为公司的实际控制人。除此之外,公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入83,235.40万元,同比增加36.40%;实现归属于母公司所有者的净利润14,087.13万元,同比增加102.58%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,934.61万元,同比增加126.43%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2022-010

常州银河世纪微电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2020年12月23日出具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)3566号)同意注册,常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“银河微电”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,210万股,每股面值1.00元,每股发行价格14.01元,募集资金总额449,721,000.00元,扣除总发行费用(不含增值税)63,604,175.47元后,募集资金净额为386,116,824.53元。主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月19日将扣除保荐承销费用(不含增值税)44,972,100.00元后的募集资金人民币404,748,900.00元汇入公司账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZP10026号)。

(二)募集资金的使用和结余情况

截至2021年12月31日,公司已使用募集资金人民币178,576,840.35元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
前次募集资金净额	386,116,824.53
减:募投项目支出	178,576,840.35
其中:募集资金置换预先投入金额	26,179,927.69
2021年募投项目支出	152,396,912.66
加:理财收益及利息收入扣除手续费	5,106,595.25
其中:2021年理财收益及利息收入扣除手续费	5,106,595.25
2021年12月31日募集资金余额	212,646,579.43
其中:2021年12月31日现金管理余额	110,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户余额	102,646,579.43

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理,公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件,制定了《常州银河世纪微电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司太湖路支行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州新北支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2021年12月31日,募集资金存储如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	期末余额
1	苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	51450700000919	1,536,711.48
2	苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	52805000000320【注】	30,000,000.00
3	苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	52390800000022【注】	50,000,000.00
4	农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021408	13,026,984.64
5	农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040021424	8,082,460.41
6	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012201676579	432.90
合计			102,646,579.43

【注】:两笔大额存单系一般性存款,账户专用于公司在苏州银行股份有限公司常州新北支行开设的募集资金专项账户51450700000919的部分资金以存单方式存放,同受《募集资金专户存储三方监管协议》的监管。

2. 截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期情况列示如下:

单位:人民币万元

合作单位	产品名称	期限	期末余额
苏州银行常州新北支行	2021年第1016期结构性存款	2021.11.29至2022.02.28	6,000.00
中国光大银行股份有限公司常州分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品60	2021.12.02至2022.03.02	5,000.00
合计			11,000.00

三、募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金,报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,617.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。同时,公司使用募集资金622.64万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。合计使用募集资金3,240.63万元置换前述预先投入的自筹资金。

上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于常州银河世纪微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZF10069号)。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下,按照相关规定严格控制风险进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款等),使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2021年12月31日,公司累计使用65,000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品,其中已赎回金额为54,000.00万元,未赎回理财产品余额为11,000.00万元。

公司2021年对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况如下:

单位:人民币万元

合作单位	产品名称	购买金额	购买日期	赎回日期	投资收益	赎回金额
苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	2021年第170期结构性存款	15,000.00	2021.02.22	2021.05.22	112.50	15,000.00
农业银行股份有限公司常州太湖路支行	“汇利丰”2021年第4250期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2021.02.23	2021.05.21	38.14	5,000.00
苏州银行股份有限公司常州分行新北支行	2021年第427期结构性存款	10,000.00	2021.05.25	2021.08.25	85.00	10,000.00
农业银行股份有限公司常州太湖路支行	“汇利丰”2021年第5128期对公定制人民币结构性存款产品	4,000.00	2021.05.28	2021.07.02	10.49	4,000.00
农业银行股份有限公司常州太湖路支行	“汇利丰”2021年第5128期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	2021.05.28	2021.09.01	58.39	6,000.00
苏州银行常州新北支行	2021年第736期结构性存款	8,000.00	2021.08.27	2021.11.27	74.00	8,000.00
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品27	6,000.00	2021.09.02	2021.12.02	47.25	6,000.00
苏州银行常州新北支行	2021年第1016期结构性存款	6,000.00	2021.11.29	2022.02.28	-	未赎回
农业银行股份有限公司常州太湖路支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品60	5,000.00	2021.12.02	2022.03.02	-	未赎回
合计	-	65,000.00	-	-	425.77	11,000.00

说明:公司与上述合作银行不存在关联关系。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2021年11月10日,经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》,公司独立董事、监事会同意公司使用超募资金1,500.00万元用于募投项目“半导体分立器件产业提升项目”新增实施地点的建设,使用超募资金4,894.00万元用于公司“车规级半导体器件产业化项目”的设备采购。2021年11月26日,上述议案获2021年第三次临时股东大会审议通过。本次对募投项目超募资金的使用,系根据公司实际情况综合考虑作出的审慎决定。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下,使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内,变更募集资金投资项目的具体情况表详见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司2021年度募集资金投资项目不存在未达到计划及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至2021年12月31日,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)发表鉴证结论:我们认为,银河微电2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了银河微电2021年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投投资有限公司发表核查意见:经核查,中信建投认为,银河微电2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2022年3月15日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:常州银河世纪微电子股份有限公司2021年度

单位:人民币万元

募集资金总额				44,972.10		本年度投入募集资金总额				17,857.68	
募集资金净额				38,611.68							
变更用途的募集资金总额				6,394.00		已累计投入募集资金总额				17,857.68	
变更用途的募集资金总额比例				16.56%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额(注1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
半导体分立器件产业提升项目	是	26,690.73	28,190.73	28,190.73	15,780.55	15,780.55	-12,410.18	55.98	2024年	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	5,514.23	5,514.23	5,514.23	2,077.13	2,077.13	-3,437.10	37.67	2023年	不适用	不适用	否
车规级半导体器件产业化项目	是		4,894.00	4,894.00	0.00	0.00	-4,894.00	0.00	2024年	不适用	不适用	无
超募资金	是	6,406.72	12.72	12.72	0.00	0.00	-12.72	0.00		不适用	不适用	不适用
合计		38,611.68	38,611.68	38,611.68	17,857.68	17,857.68	-20,754.00					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。								

(下转B066版)